



2026 年 9 月 30 日

各 位

上場会社名 メック株式会社
代表者 代表取締役社長 前田 和夫
 (コード番号 4971 東証プライム市場)
問合せ先責任者 コーポレートコミュニケーション室 松下 綾
 (TEL 06-6401-8160)

生産能力増強に向けた設備投資（固定資産の取得）の追加に関するお知らせ

当社は、本日、半導体パッケージ基板関連製品を中心とした需要の拡大および生産拠点の分散化を通じた BCP（事業継続計画）の強化を目的に、設備投資を実施することを決定いたしましたのでお知らせします。

本設備投資は、2026 年 12 月稼働開始を予定している当社北九州工場の第 2 期工事となります。

記

1. 取得の理由

近年生成 AI の急速な進化を背景に、電子基板・部品の需要が拡大しています。さらに今後もさまざまな AI 関連の進化が継続することが見込まれる中、当社では、この需要拡大による持続的な成長機会を確実に取り込むべく、新工場（北九州工場）の建設を 2026 年 12 月稼働開始に向け進めています。

新工場の生産能力については、需要動向を見据えながら適宜増強を図る方針でありましたが、近年の AI 関連投資の拡大を背景に、特に当社では半導体パッケージ基板関連製品の需要が高水準で増加するものと見込んでおり、こうした需要動向に対応するため、当初の計画からより幅広い製品需要への対応に加え、関連法令への対応も踏まえた追加の設備投資を行うことを決定いたしました。

2. 設備投資の概要

- | | |
|------------|--|
| (1) 内容 | さらに増加が見込まれる半導体パッケージ基板の需要に対応すべく、当社製品（薬品）生産工場である北九州工場（北九州市）において設備を増強いたします。 |
| (2) 投資額 | 約 20 億円 |
| (3) 稼働開始時期 | 2028 年度（予定） |
| (4) 資金計画 | 自己資金および借入金（予定） |

3. 今後の見通し

2026 年 12 月期連結業績への影響は軽微であります。

以 上